

证券代码：688173

证券简称：希荻微

公告编号：2024-003

希荻微电子集团股份有限公司

关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）将注销 811,000 股已回购股份，占注销前公司总股本 410,561,733 股的比例为 0.20%。本次注销完成后，公司总股本将由 410,561,733 股变更为 409,750,733 股。
- 回购股份注销日期：2024 年 1 月 24 日。

公司于 2023 年 11 月 22 日召开第一届董事会第四十三次会议、第一届监事会第三十二次会议，于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司注销全部回购股份共 811,000 股，并相应减少公司注册资本。2023 年 12 月 9 日，公司披露了《希荻微电子集团股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-091），公告披露之日起 45 日内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的情况。本次注销回购股份日期为 2024 年 1 月 24 日，现将相关事项公告如下：

一、回购股份的情况

2023 年 8 月 23 日，公司召开了第一届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元，不超过人民币 3,000 万元，回购价格为不超过 31 元/股（含本数），回购期限为自董

事会审议通过股份回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-055）、《希荻微电子集团股份有限公司关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-058）。

截至 2023 年 10 月 13 日，公司完成回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 811,000 股，占公司总股本 409,150,567 股的比例为 0.20%，回购成交的最高价为 18.96 元/股，最低价为 16.70 元/股，均价为 18.50 元/股，支付的资金总额为人民币 15,001,768.88 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于股份回购实施结果公告》（公告编号：2023-071）。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于 2023 年 11 月 22 日召开第一届董事会第四十三次会议、第一届监事会第三十二次会议，于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司注销全部回购股份共 811,000 股，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2023-080）。

三、回购股份注销的办理情况

因公司本次注销回购股份导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《希荻微电子集团股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-091），上述债权申报期限已于 2024 年 1 月 22 日届满，申报期间公司未收到相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的情况。

公司已向上海证券交易所递交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销

日期为 2024 年 1 月 24 日。后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

四、回购股份注销后公司总股本的变动情况

自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过本次回购股份注销事项之日起至债权申报期限届满日期间，因公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期第五次行权新增了股本 1,411,166 股，公司总股本由 409,150,567 股变更为 410,561,733 股，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期第五次行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-002）。据此，本次回购股份注销后，公司总股本将由 410,561,733 股减少为 409,750,733 股。具体股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		注销回 购股份 数量 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股	171,103,880	41.68	0	171,103,880	41.76
无限售条件流通股	239,457,853	58.32	811,000	238,646,853	58.24
总股本	410,561,733	100.00	811,000	409,750,733	100.00

注：公司股本结构变动以股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 24 日